

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2026-054

天津金海通半导体设备股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年7月24日召开第二届审计委员会第二十二次会议、第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，现将公司截至2026年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2023年2月公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股发行价为人民币58.58元，募集资金总额为人民币878,700,000.00元，根据有关规定扣除发行费用131,888,125.09元（不含税）后，募集资金净额为746,811,874.91元，该募集资金已于2023年2月24日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]361Z0008号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）前次募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金60,317.76万元。截至2026年6月30日，募集资金账户余额为人民币13,109.65万元。

单位：万元 币种：人民币	
项目	金额
一、募集资金总额	87,870.00
减：直接支付发行费用	13,188.81

二、募集资金净额	74,681.19
减：	
截至 2025 年 12 月 31 日已使用金额	53,804.08
2026 年 1-6 月使用金额	6,513.68
现金管理金额	3,400.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.17
加：	
募集资金利息收入	2,146.39
三、报告期期末募集资金余额	13,109.65

注：以上表格中的金额以四舍五入的方式保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（三）前次募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、上海银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司江苏金海通半导体设备有限公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	截止 2026 年 6 月 30 日余额	账户状态
天津金海通半导体设备股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	77230078801900001822	12,833.02	使用中
天津金海通半导体设备股份有限公司	上海银行股份有限公司天津华苑支行	03005262096	64.36	使用中
江苏金海通半导体设备有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012301598875	212.27	使用中

天津金海通半导体设备股份有限公司	上海银行股份有限公司天津华苑支行	03005261995	—	已注销
合计			13,109.65	

注：以上表格中的金额以四舍五入的方式保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资的项目为：半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目、年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目、补充流动资金，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终止募投项目“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”，并将剩余募集资金 3,205.05 万元继续存放募集资金专户管理，公司将积极筹划寻找新的投资项目或审慎研究判断现有项目是否追加投资，保荐机构出具了核查意见。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”实际投资总额与承诺的差异主要原因系项目处于建设期，募集资金将继续用于实施承诺项目所致。

2、“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”已终止，公司将剩余募集资金 3,205.05 万元继续存放募集资金专户管理。

3、“补充流动资金”实际投资总额与承诺的差异主要原因系累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

1、闲置募集资金现金管理情况

公司于2023年3月23日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。

公司于2024年3月18日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等，自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具了核查意见。

公司于2025年2月26日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等，自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具了核查意见。

公司于2026年2月2日召开第二届董事会审计委员会第十七次会议，2026年2月3日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等，自公司第二届董事会第二十四次会议审

议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具了核查意见。

2、尚未使用的募集资金情况

截至2026年6月30日，公司前次募投项目已累计使用募集资金60,317.76万元，尚未使用的募集资金余额为16,509.65万元(含累计收到利息收入和投资理财产品收益的净额，其中使用闲置募集资金进行现金管理未到期的金额3,400.00万元、募集资金账户余额13,109.65万元)，未扣减补充流动资金后的前次募集资金使用比例为80.77%，同时扣减补充流动资金后的前次募集资金使用比例为73.53%，尚未使用募集资金占募集资金净额的比例为22.11%，募集资金未使用完毕主要系项目尚未建设完毕。随着募集资金投资项目建设不断推进，募集资金将逐步投入使用。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“补充流动资金”项目的目的在于优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，保持公司经营的稳定性，无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

前次募投项目中，“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”尚在建设期，未达可使用状态；“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”已终止实施。前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的相关内容一致，不存在差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 25 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：天津金海通半导体设备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额：74,681.19						已累计使用募集资金总额：60,317.76				
变更用途的募集资金总额：3,205.05						各年度使用募集资金总额：60,317.76				
						2023 年：35,478.16				
						2024 年：8,678.68				
						2025 年：9,647.24				
变更用途的募集资金比例：4.29%						2026 年 1-6 月：6,513.68				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可以使用状态 日期
序号	承诺投资项 目	实际投资项 目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承诺投资 金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	
1	半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目	半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目	43,615.04	43,615.04	32,567.80	43,615.04	43,615.04	32,567.80	-11,047.24	2026 年 10 月
2	年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目	年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目	11,066.15	7,861.10	7,636.96	11,066.15	7,861.10	7,636.96	-224.14	已终止（注 1）
				3,205.05	—		3,205.05	—	-3,205.05	暂未确定投向
3	补充流动资金	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	20,113.00	20,000.00	20,000.00	20,113.00	113.00 (注 2)	不适用
合计			74,681.19	74,681.19	60,317.76	74,681.19	74,681.19	60,317.76	-14,363.43	—

注 1：公司终止募投项目“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”，并将剩余募集资金 3,205.05 万元继续存放募集资金专户管理，公司将积极筹划寻找新的投资项目或审慎研究判断现有项目是否追加投资。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-024）以及于 2025 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。

注 2：补充流动资金项目募集资金累计投入进度大于 100%系使用了募集资金的利息收入、现金管理投资收益所致。

注 3：“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”已终止，但截至 2026 年 6 月 30 日止，实际投资金额与募集后承诺投资金额之间尚存 224.14 万元差额（系根据合同计算的暂估金额，最终以项目实际支付为准），上述差额因相关款项尚未完成支付所致。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：天津金海通半导体设备股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年	2023 年		
1	半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目	不适用	未来达产后预计新增年均净利润 22,518.13 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 1）
2	年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 2）
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 3）

注1：“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”尚处于建设期，暂未达到产出条件。

注2：公司终止募投项目“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”，并将剩余募集资金3,205.05万元继续存放募集资金专户管理，公司将积极筹划寻找新的投资项目或审慎研究判断现有项目是否追加投资。具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-024）以及于2025年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。

注 3：“补充流动资金”无法单独核算效益。